

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

投资者关系活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 电话会议 □ 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、方正富邦、东方阿尔法、国寿资产、易方达、德邦基金
时间	2026 年 9 月 17 日(周四) 10:00-11:00 2026 年 9 月 17 日(周四) 15:30-16:30 2026 年 9 月 18 日(周五) 10:00-11:00 2026 年 9 月 21 日(周一) 9:40-10:40 2026 年 9 月 21 日(周一) 15:00-16:00
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦

投资者关系活动 主要内容介绍	1、存储价格上涨，存货当中的低价晶圆大量消耗后，公司盈利能力将如何变化？ 答：公司采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本，存储晶圆价格上涨的影响已动态反映在实际营业成本中。与此同时，存储价格增长反映的是行业供需关系及产业景气度改善，而非单一的成本变动。 从存储器行业的历史经营情况看，企业的长期盈利能力既取决于技术实力、产业链协同能力等综合竞争优势，也与高端客户占比密切相关。具备领先技术能力、多元化产品矩阵及完善产业链布局的企业，能够更好满足大客户对产品性能、兼容适配、可靠性及稳定供货等方面的综合要求，从而持续提升高端客户占比。通常而言，高端客户占比较高的企业，具有更强的盈利能力和相对明显的弱周期特征。 在 AI 发展浪潮下，公司坚定执行全面拥抱端侧 AI 的发展战略，前期重点投入的主控芯片、企业级存储、mSSD 等产品已陆续取得实质性商业进展，并持续深化与全球知名客户的合作和导入，不断提升高端客户收入占比，为公司业务增长及盈利能力提升提供支撑。近期，公司还推出了 HLC（高级缓存技术）、AIDIMM、AILPGBA 等全面适配端侧 AI 的新技术、新产品。随着相关产品逐步导入市场并实现更广泛的规模化应用，公司高端、高壁垒、高附加值产品的收入占比有望进一步提升，持续优化产品结构和盈利结构。 2、HLC 技术是如何实现存储的更高效利用的？HLC 技术的研发与商业化进展情况如何？如何看待 HLC 技术的市场空间？ 答：HLC 技术基于公司自研高性能主控芯片、专属固件与系统级架构的协同配合，让 SSD 或 UFS 存储设备承接原本由 DRAM 负责的温冷数据缓存工作，将高度依赖 DRAM 的缓存负载精准卸载至 NAND 中，在维持系统性能的前提下，能够
---------------------------	---

	有效降低终端设备的 DRAM 配置要求。 公司已与 AMD、紫光展锐、全球 SoC 头部企业、全球 CPU 头部企业等多家主芯片厂商开展 HLC 相关技术的适配工作。其中，基于与 AMD 的联合调优，在 AI 移动工作站及 AI PC 平台的测试数据显示，搭载公司智能软硬件架构的设备，相比传统存储方案，AI PC 端模型规模提高约 3.2 倍，内存利用效率提升约 200%。 目前，“内存墙”的物理限制与高昂的内存成本，已成为大模型在端侧 AI 广泛应用的重要阻碍。HLC 技术与配套产品生态，在保证客户体验基本不变的前提下，能够实现 NAND Flash 与 DRAM 整体存储方案在成本和技术优化层面的最优解，具备极为广阔的市场应用前景。公司正与重要合作伙伴一道，推进相关技术的产品化和市场推广。 3、如何看待 AIDIMM 的应用前景？ 答：公司发布的 AIDIMM，作为针对 AI 计算深度优化的内存，最高容量达 128GB，带宽最高达到 307.2GB/s，根据公开资料，HBM2 容量为 8GB，理论峰值带宽为 256-307GB/s，AIDIMM 的容量、带宽等关键指标也远优于 UDIMM、SODIMM 等传统内存产品。 AIDIMM 产品采用 4 颗 LPDDR5x 同面布局设计，可适配主流智能体主机的主板架构，无需对现有硬件进行大幅改造。AIDIMM 能有效解决当前智能体主机普遍存在的内存容量不足、算力任务卡顿等核心难题，为 AI PC、智能体主机提供高性能、低功耗、易升级的 AI 内存解决方案，更好释放终端 AI 算力。 4、如何看待存储价格未来变化趋势？ 答：结合第三方机构公布的信息来看，AI 在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量；受过往周期影响，海外原厂仍维持相对审慎的 NAND
--	---

	资本开支计划，更多通过技术升级实现相对温和的 NAND 供给增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无